

## 成都银河磁体股份有限公司

## 关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开的第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》,截至2023年12月31日,公司募集资金余额26,140,776.53元,公司募集资金专户尚余两个:浙商银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都第九支行。为方便管理,拟注销在中国建设银行股份有限公司成都第九支行开立的募集资金专户(账号:51001498408059988888),该专户存放的超募资金全部转至浙商银行股份有限公司成都分行管理。

公司募集资金使用及存放具体情况如下:

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]1236号)文核准,公司于2010年9月20日由主承销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)4,100万股,发行价格为每股人民币18.00元,已收到募集资金人民币738,000,000.00元,扣除各项发行费用共计41,426,765.84元后,实际收到募集资金净额为人民币696,573,234.16元。上述资金到位情况经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司验证,并出具川华信验(2010)65号《验资报告》。

#### (二) 2023年度募集资金使用情况及节余情况

截至2023年12月31日,公司募集资金使用情况

单位:人民币元

项 目	期初累计使用金额	本年发生额	期末累计使用金额
募集资金到账金额	696,573,234.16		696,573,234.16

减:	高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目	72,488,453.15		72,488,453.15
	节余资金及利息永久补充流动资金	72,791,800.36		72,791,800.36
减:	高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目	26,126,026.27		26,126,026.27
	节余资金及利息永久补充流动资金	24,442,127.66		24,442,127.66
减:	7号厂房项目	20,389,655.93		20,389,655.93
减:	钕钴磁体项目	15,867,197.40		15,867,197.40
减:	热压磁体项目	27,074,541.06		27,074,541.06
减:	投资设立子公司(钕铁硼微晶磁粉生产项目)	40,000,300.50		40,000,300.50
减:	用于提前偿还银行贷款(审议程序见公告 2010-01)	72,720,000.00		72,720,000.00
减:	永久补充流动资金(审议程序见公告 2010-01)	29,000,000.00		29,000,000.00
减:	永久补充流动资金(审议程序见公告 2011-30)	80,000,000.00		80,000,000.00
减:	永久补充流动资金(审议程序见公告 2017-016)	150,000,000.00		150,000,000.00
减:	永久补充流动资金(审议程序见公告 2023-002)		150,000,000.00	150,000,000.00
加:	募集资金利息收入扣除手续费净额	55,101,992.99	79,342.51	55,181,335.50
加:	理财利息收入扣除手续费净额	48,851,309.20	6,435,000	55,286,309.20
	尚未使用的募集资金余额	169,626,434.02		26,140,776.5

### (三) 募集资金专户存储情况

1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

项目/开户银行		分 类		报告期末募集资金余额合计
		活期	定期	
<b>其他与公司主营业务相关的营运资金：</b>				
浙商银行股份有限公司成都分行	6510000010120100279950	26,081,181.63	0.00	26,081,181.63
中国建设银行股份有限公司成都第九支行	51001498408059988888	59,594.90		59,594.90
小计		26,140,776.53	0.00	26,140,776.53

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日